《硅微机械传感器技术》

书籍信息

版次:1 页数: 字数:

印刷时间:2012年12月01日

开本:16开 纸张:胶版纸 包装:平装 是否套装:否

国际标准书号ISBN: 9787308108799

编辑推荐

本书详细描述了多种硅微机械传感器的工作原理。本书从有关硅微机械传感器设计所需的基本科学知识开始,论述了包括物理定律的按比例缩小、流体流动和热传递的基本规律。此外还向读者介绍了硅微机械加工工艺和传感器封装的基本知识,并用压力传感器、力学传感器和流体传感器的众多例子说明了设计、制造和性能方面的有关问题。

内容简介

导语郑志霞所著的《硅微机械传感器》分为两部分:第一部分根据微机械加工的工艺流程,逐步展开介绍微机械传感器的工艺技术和一些特殊工艺。第二部分介绍硅微机械传感器的*研究成果,主要包括微压力传感器、微加速度传感器、微机械陀螺、微热流量传感器等。内容提要郑志霞所著的《硅微机械传感器》围绕硅微机械传感器的基本原理、工艺技术、应用领域及接口电路等几个方面展开介绍和讨论。主要内容有:微机械系统的发展历史、现状、应用领域及前景;硅的物理、化学、机械特性;微机械传感器的主要工艺技术和特殊T艺的研究;常见微机械传感器结构;硅微机械压力传感器、加速度传感器、角速度传感器、热流体传感器的基本原理、结构设计、工艺过程及应用等;常见传感器的接口电路;微机械传感器的封装技术及几种常见微传感器的封装。《硅微机械传感器》可供从事微机械传感器、光电子技术、通信技术、精密仪器与检测技术等的教学、科研、工程技术人员以及高等院校的师生参考。

目录

- 1 MEMS和MEMS传感器
- 1.1 微电子机械系统(MEMS)
- 1.2 微机械传感器研究的现状与发展方向
- 本章参考文献
- 2 硅的基本特性
- 2.1 硅晶体结构
- 2.2 硅的电学性质
- 2.3 硅的光学、热学性质

- 2.4 硅的机械性质
- 2.5 硅的化学性质
- 本章参考文献
- 3硅片清洗与光刻工艺
- 3.1 硅片的清洗
- 3.2 光刻工艺

显示全部信息

版权信息

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。 更多资源请访问www.tushupdf.com